

正本

檔 號：

保存年限：

## 國立中興大學 書函

機關地址：40227臺中市南區興大路145號  
承辦人：鄭渝靜  
聯絡電話：04-22840206-22  
電子郵件：yccheng@nchu.edu.tw

受文者：材料科學與工程學系

發文日期：中華民國112年1月18日

發文字號：興國字第1120001015號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：函轉公益財團法人日本台灣交流協會(下稱交流協會)2023年度出席國際學術會議經費資助相關訊息，請查照。

說明：

一、交流協會為支援台灣發展日本研究，資助台灣籍日本研究者參加國際學術會議、國際論壇等進行研究發表所需之旅費等相關費用。

二、本項計畫資助對象為持碩士以上學位之台灣籍研究者，於社會科學或人文科學領域以日本為對象之研究、或研究的重要案例以日本為對象之研究發表。

三、申請期間：

第1回（4月~9月30日，此期間內實施/結束的活動）：2023年2月10日（五）前寄達；

第2回（10月~2024年3月31日，此期間內實施/結束的活動）：2023年7月28日（五）前寄達。

四、相關申請資訊請檢閱附件及參照交流協會網頁：

<https://www.koryu.or.jp/tw/business/study/presentation/application/>

五、其他連絡方式：日本台灣交流協會台北事務所新聞文化部 謝小姐 電話：02-27138000分機2412。

正本：本校各學院、系、所、學位學程

副本：國際事務處

# 國立中興大學

本案依分層負責規定授權單位主管決行

裝

言

線